### (54) AROMATIC POLYIMIDE RESIN COMPOSITION

(11) 2-222451 (A) (43) 5.9.1990

(21) Appl. No. 64-43430 (22) 23.2.1989

(71) TORAY IND INC (72) ATSUSHI SUZUKI(1)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C08L79/08,C08L79/04

PURPOSE: To obtain an aromatic polyimide resin composition having excellent heat resistance and mechanical properties, etc., and improved processability by comprising aromatic polyimide resin and thermosetting poly(iso)imide oligomer having acetylene terminal.

CONSTITUTION: (A) 99.9-50wt.% aromatic polyimide resin, preferably obtained from pyromellitic acid dianhydride and 4,4'-diaminodiphenylether is mixed with (B) 0.1-50wt.%, preferably 0.5-30wt.% thermosetting polyimide oligomer expressed by formula I (Ar<sub>1</sub> is tetrafunctional aromatic residue; Ar<sub>2</sub> is bifunctional aromatic residue; n is 0-30, preferably 1-10) and/or thermosetting polyisoimide oligomer expressed by formula II, obtained from aromatic tetracarboxylic acid dianhydride, aromatic diamine and aminophenylacetylene to afford the aimed composition.

### (54) RESIN COMPOSITION

(11) 2-222452 (A) (43) 5.9.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-41896 (22) 23.2.1989

(71) DAINIPPON INK & CHEM INC (72) YOSHIYUKI ONO(3)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C08L81/02,C08L101/00

PURPOSE: To obtain a resin composition having improved compatibility in blending and impact resistance by comprising a resinous substance obtained by mixing polyarylene sulfide with other thermoplastic resin in organic solvent of high temperature and separating and a thermoplastic resin.

CONSTITUTION: A₁: 20-80wt.% polyarylene sulfide expressed by formula I (Ar is arylene group containing preferably ≥70mol%, especially ≥90mol% p-phenylene) is mixed with A₂: 80-20wt.% thermoplastic resin except A₁, preferably polysulfone or polyethersulfone, etc., having repeating unit expressed by formula II or formula III, etc., in an organic solvent (e.g., p-chloronaphthalene) at 100-400°C and separated to obtain a resinous substance (A). Then, 1-99 pts.wt. The component A is mixed with 99-1 pts.wt. the component B: A₁ and/or A₂, and fibrous or granular reinforcing agent, as necessary, to afford the aimed resin composition.

$$(-Ar-S-)_{\bullet}$$

$$+\bigcirc \bigcirc -0 - \bigcirc -S0_{\bullet} \rightarrow$$

$$\square$$

$$+ \bigcirc - \bigcirc CH_{3} \longrightarrow 0 \longrightarrow SO_{3} \longrightarrow$$

### (54) FLUOROSILICONE RUBBER COMPOSITION

(11) 2-222453 (A)

(43) 5.9.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 64-44157 (22) 23.2.1989

(71) TOSHIBA SILICONE CO LTD (72) HIROFUMI YOSHIDA

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. C08L83/08,C08K3/36

PURPOSE: To obtain the title composition excellent in processability. oil resistance, mold nonstainability, etc., thus suitable as a sealing material for rolls, connectors, etc., by incorporating a specific organopolysiloxane with each specified amount of a specific oily organopolysiloxane, reinforcing silica powder, etc.

CONSTITUTION: The objective composition can be obtained by incorporating (A) 100 pts.wt. of an organopolysiloxane ≥1000cps in viscosity of formula I [R is made up of 25-50mol% of group of formula II (R₁ is 1-3C perfluoroalkyl) and 75-50mol% of (saturated)monovalent hydrocarbon; a is 1.98-2.02] with (B) 3-15 pts.wt. of an oily organopolysiloxane 20-10000cps in viscosity of formula III [R' is made up of 5-30mol% of the group of the formula II (the difference from that in the component A being 20-45 mol%) and 95-70mol% of methyl, etc.; b is 1.98-2.02]. (C) 10-100 pts.wt. of reinforcing silica powder ≥50m²/g in specific surface area, and (D) a curing agent.

$$-$$
 C H  $_2$  C H  $_2$  R  $_f$ 

(F)

1/5/4

### DIALOG (R) File 352:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

### 008428342

WPI Acc No: 1990-315343/199042

XRAM Acc No: C90-136182

Resin compsn. for prodn. of electric and electronic machine parts - contains resinous prod. prepd. by dissolving polyarylene sulphide and thermoplastic resin in hot organic solvent and cooling

Patent Assignee: DAINIPPON INK & CHEM KK (DNIN )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent-Family:

 Patent No
 Kind
 Date
 Applicat No
 Kind
 Date
 Week

 JP 2222452
 A 19900905
 JP 8941896
 A 19890223
 199042
 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8941896 A 19890223

### Abstract (Basic): JP 2222452 A

Resin compsn. comprises, (a) a resinous prod. prepd. by dissolving polyarylene sulphide (PAS) and other thermoplastic resin to heated organic solvent and depositing as a resin mixt. after cooling, and (B) PAS and/or other thermoplastic resin.

Pref. PAS is of formula - (-Ar-S-) -, where Ar is o, m or p-phenylene (Ph), or -Ph-O-Ph-, -Ph-CO-Ph-, -Ph-CH2-Ph-, -Ph-C (CH3) 2-Ph- or Ph-SO-Ph-. The ratio of (Resinous matter) / (Polyphenylene sulphide) / (Other thermoplastic resin) = (1-60) / (99-20) / (1-80), esp. (2-40) / (95-70) / (5-70) wt.%. The organic solvents are alpha-chloro naphthalene or diphenyl ether. The thermoplastic resin are polycarbonate series resins. Reinforcing fillers, (5-500 wt.%) of fibres or glass powder are opt used, and they are modified with coupling agent before use.

USE/ADVANTAGE - Prods. have good mechanical properties. The compsn. is useful for prodn. of electric and electronic machine parts, e.g. connector, print circuit base, sealed prod., or interior parts for car, aircraft, building, or sports and leisure goods, or machine parts for camera and OA-machine. (8pp Dwg.No.0/0)

Title Terms: RESIN; COMPOSITION; PRODUCE; ELECTRIC; ELECTRONIC; MACHINE; PART; CONTAIN; RESINOUS; PRODUCT; PREPARATION; DISSOLVE; POLYARYLENE; SULPHIDE; THERMOPLASTIC; RESIN; HOT; ORGANIC; SOLVENT; COOLING

Derwent Class: A23; A26; A85; L03

International Patent Class (Additional): C08L-081/02; C08L-101/00

File Segment: CPI

### ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### 平2-222452 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)9月5日

C 08 L 81/02 101/00

LRG LSY

8830-4 J 7445-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

60発明の名称 樹脂組成物

> ②符 願 平1-41896

願 平1(1989)2月23日 ❷出

@発 明 者 小 簭 之 千葉県佐倉市六崎1550-2-1-201

登 @発 明 者 能

好 文 埼玉県浦和市三室2982-1 千葉県佐倉市城内町76-2

田 個発 明 者 村 者

髙 桂 子

千葉県佐倉市六崎211

個発 飯 大日本インキ化学工業 の出 顖

東京都板橋区坂下3丁目35番58号

株式会社

野

田

個代 理 人

明

弁理士 高橋 勝利

細 奪

### 1. 発明の名称 樹脂組成物

### 2. 特許請求の範囲

1. ポリアリーレンスルフィドと他の熱可塑性 樹脂を高温の有機溶媒中で混合後に析出させた樹 脂状物質と、ポリアリーレンスルフィドおよび (または) 他の熱可塑性樹脂とからなる樹脂組成 物。

### 3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は、ポリアリーレンスルフィド(以下 PASと略す。)と他の熱可塑性樹脂を高温の有 機溶媒中で混合後に折出させた樹脂状物質を含ん でなるブレンド相溶性や耐衝撃性を改善した樹脂 組成物に関する。

かかる組成物は、射出成形・圧縮圧形、押出成 形・引抜成形などの各種成形法により種々の成形 品を与えることができ、いろいろな分野において 利用できる。

(従来技術および発明が解決しようとする課題)

ポリフェニレンスルフィド(以下、PPSと略 す。)で代表されるPASはそれ自体すぐれた耐 熱性、耐溶剤性、難燃性を有しており、エレクト ロニクス分野を初めとして各種の成形加工分野に 利用されている。

しかし、PASは優れた性能を有する反面、非 強化のものは非常に脆く、耐衝撃性に代表される 機械的な性質が不十分であるため、成形材料とし て用いられる応用分野が限られているのが現状で ある。

これまでPASに他の熱可塑性樹脂をプレンド させることによって耐衝撃性、柔軟性等の特性を 向上させようとの試みもなされたが、両者の相溶 性が不十分であることが多く、単純なプレンド系 は成功していない。そのため例えば特開昭59-58052、同59-155461、同59-155462、同59-164360号公報のよ うにノボラック系エポキシ樹脂をプレンド相溶化 剤に用いてPPSと他の熱可塑性樹脂とをブレン

ドする試みもなされたが、使用するPPSが架構 度の低いものに限られ、また成形時におけるエポ キシ樹脂の耐熱性も難があり、ゲル化し易くで成 形時の作業性に問題が生じる欠点もあった。

また、PPS部分とポリフェニレンスルフィドスルホン部分とからなるブロック共重合体(特別昭62-205157号公報)あるいはPPS部分とポリサルホン部分とからなるブロック共重合体(特別昭61-247755号公報)を用いる はとも試みられているが、ブロック共重合体を製造するので簡便であるとは云えず、またブロック 的 がと同じ樹脂で選択の範囲が狭いなどの欠点があった。

### (課題を解決するための手段)

本発明者らは耐熱性、耐薬品性、剛性などに優れるPASの性質を生かしつつ、耐衝撃性、柔軟性などの特性が改善でき、あわせてPASやその他の熱可塑性樹脂とも広範囲にプレンド可能な樹脂を出来るだけ簡便に得るべく鋭意研究した結果、

(一〇) - 80: -(○) - ) などの如き少なくとも 2

個の炭素数6の芳香環を含む2価の芳香族残基であり、さらに、各芳香環には P、 C L 、Br、 CR。などの置換基が導入されることもある。これらはホモボリマーであっても、ランダム共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい。

特に、本発明で使用するに好ましいPASは、パラレルプレート型の粘度計で測定を行った、300℃、100rad/sec での複素粘性率の実数部 ( n ´ ) が 10° ~10° poise 、好ましくは500~500 poise の範囲内にある溶融粘度を有し、上記PASの一般構造式中の一Ar 一部分の70モル%以上、特に好ましくは90モル%以

上がp‐フェニレン( 一〇 ) 部分からなる

PPSである。用いられるPPSの分子額の形状は、線状、分岐状あるいは一部架構型およびその 混合物である。また、PPSに含まれる PASと他の熱可塑性樹脂を高温の有機溶媒中で混合後に折出させた樹脂状物質が、PASやその他の熱可塑性樹脂とのプレンド相溶性に優れることを見い出し、本発明に到達した。

即ち、本発明はPASと他の熱可塑性樹脂を高温の有機溶媒中で混合後に折出させた樹脂状物質と、PASおよび(または)他の熱可塑性樹脂とからなる樹脂組成物を提供するものである。

本発明における樹脂状物質の構成成分であり、また該樹脂状物質と混合され得るPASは、構造式 (-Ar-S-)。 (Ar:アリーレン基)で表わされる重合体である。ここでアリーレン基の-Ar-は、p-フェニレン、m-フェニレン、o-フェニレン、 2.6ナフタレン、 4.4 ピフェニレン、

$$b \in V : \mathbb{R} \quad (-\langle O \rangle - 0 - \langle O \rangle),$$

$$(-\langle O \rangle - C(CH_2)_2 - \langle O \rangle),$$

PPSの市販品としては、フリップス・ペトロリアムのライトンPPS、東レの東レPPSなどがある。

ド、フッ素系樹脂やエチレン、プロピレン、ブチレン、ペンテン、ブタジエン、イソブレン、スチレン、(メタ)アクリル酸エステル、(メタ)アクリロニトリル等の単量体の単独重合体吸いは共 重合体、又はプロック及びグラフト共重合体、更にはマレイン酸グラフト化エチレンーブテン共重 合体や硫酸、酸化剤などで変性されたポリオレフィンの如き変性された(共)重合体が挙げられる。なかでも好ましいものは、

返し単位を有するポリサルホン、ポリエーテルサ ルホン、ポリアリールサルホン;

(式中、Arは3個の芳香族基、8 は2個の芳香族基及び/又は2個の脂肪族基、 8 は水素、脂肪族基又はフェニル基)で代表されるポリアミドイミドなどである。 (特開昭59-64667、同59-155462、同59-164360号公報参照)

本発明組成物中に用いられる樹脂状物質は、前記したPASと他の熱可塑性樹脂を高温の、場合によっては高温ー加圧下にある有機溶媒中で混合後、析出させることにより得られる。

得られる樹脂状物質の効果を高めるために、 PASと他の熱可塑性樹脂を高温の有機溶媒中で 混合処理する際に必要に応じて硫黄、有機過酸化 物等の改良剤を配合することも可能である。

樹脂状物質中におけるPASの比率は20~ 80重量%であり、好ましくは30~70重量% である。

混合する際の有機溶媒は、PASと他の熱可塑性樹脂を実質的に溶解あるいは膨潤する溶媒、例えばα-クロロナフタレン、α-メチルナフタレ

返し単位を有するポリエーテルケトン、ポリエー テルエーテルケトン;ピスフェールAの如きピス フェノール誘導体とイソフタル酸、テレフタル酸 鋭いはこれらの誘導体の如き二塩基酸とから好適 に合成されるポリアリレート: 2,6-ジ置換フェ ノールの重合体政いは 2,6-置換フェノールと多 価フェノールとの重合体であるポリフェニレンオ キサイド;ポリエチレンテレフタレート、ポリブ チレンテレフタレート、ポリ (シクロヘキサンジ メチレンテレフタレート)に代衷される熱可塑性 ポリエステル:ナイロンー6、ナイロンー66、 ナイロンー64、ナイロンーMXD 6(m-キシレ ンジアミンとアジピン酸との共重合体)に代衷さ れるポリアミド;ピスフェノール類をベースとし、 これとジフェニルカーポネートとの反応或いはホ スゲンとの反応などにより得られるポリカーポネ

$$- + : - \cancel{R} \preceq \qquad \qquad \left( \begin{matrix} R \\ I \\ I \end{matrix} - C - A \begin{matrix} 0 \\ I \\ C \\ I \end{matrix} \right) \begin{matrix} 0 \\ C \\ C \\ I \end{matrix}$$

ン、ローメチルー2ーピロリドン、ジフェニルエーテル、ジフェニールなどが用いられる。これらは、単独あるいは2種以上を混合して用類、熱可要性樹脂の種類やPASとの混合比率ないが、通常100~400での範囲である。100で未満ではブレンド相溶性を向上させるような樹脂が多ではブレンド相溶性を向上させるような樹脂が多ではブレンド相溶性を向上させるような樹脂が多の熱可塑性樹脂の分解が著しくて好ましくない。

有機溶媒の使用量も樹脂を実質的に溶解、混合できうる範囲内であれば制限はないが、生産性を 高めるためには可能な範囲で高濃度にすることが 望ましい。

樹脂状物質の析出は、冷却析出法、非溶媒の添加による沈融法、溶媒留去法など高分子溶液から 高分子物質を分離するための各種方法の単独ある いはこれらの組み合わせによりなし得る。

本発明の樹脂組成物は、前配した樹脂状物質 1 ~99重量部、好ましくは 3~95重量部に対し

### 特開平2-222452(4)

てPPSを併用する場合にはPPSを99~1重量部、好ましくは97~5重量部、他の熱可塑性 樹脂を併用する場合には熱可塑性樹脂99~1重量部、好ましくは95~5重量部含有するものである。(但し、合計を100重量部とする。)

また樹脂状物質に P P S および他の熱可塑性樹脂を併用する場合には、 (樹脂状物質) / (PPS) / (他の熱可塑性樹脂) = 1 ~ 60/99~20 /1~80、好ましくは 2~40/95~70/5~70 (合計を 100重量部とする。) の割合で含有するもである。

商、樹脂状物質中の熱可塑性樹脂と、後にプレンドする熱可塑性樹脂とは必らずしも同一である必要はなく、プレンド相溶性が阻害されない範囲であれば異なる樹脂を用いることも可能である。

本発明組成物には、必要に応じて繊維状または 粒状の強化剤を配合することが可能であり、 樹脂 組成物に対して、通常 5 ~ 3 0 0 重量%の範囲で 配合することによって強度、 附性、 耐熱性、 寸法 安定性を向上させることができる。 繊維状強化剤 としては、炭素繊維、ガラス繊維、シランガラス 繊維、セラミック繊維、アスペスト繊維、金属繊 雑などが挙げられる。また、粒状の強化剤として は、マイカ、タルクなどの珪酸塩や炭酸塩、硫酸 塩、金属酸化物、ガラス・ビーズ、シリカなどが 挙げられる。これらは2種類以上併用してもよく、 また必要によってシラン系などのカップリング剤 で処理することもできる。

本発明の樹脂組成物の調製方法は特に制限はなく、例えば通常の溶験押出機によって溶酸混練し、ペレタイズする方法などでよい。溶融温度は 280~400℃が好ましく、400℃を越えると樹脂が分解するので好ましくない。

### (発明の効果)

本発明の樹脂組成物は、例えば、コネクタ、プリント基板、封止用成形品などの電気・電子部品、ランプリフレクター、各種電装品などの自動車部品、各種建築物・自動車・航空機などの内装用材料、テニスラケット、ゴルフクラブ、約竿などのレジャー・スポーツ用具、あるいは O A 機器部品、

カメラ部品などの精密部品等の射出成形・圧縮成形、あるいはコンポジットシート、パイプ、シートなどの押出成形・引抜成形や繊維などの各種成形加工分野において、耐衝撃性に優れた成形材料として用いられる。

### (実施例)

例を挙げて本発明を配明するが、本発明はこれ らに限定されるものではない。

### 実施例1~5、比較例1~5

PPS (ライトン PRO-6、フィリップスペトロリアム社製 [n]) = 800~1000poise ) にブレンドする他の熱可塑性樹脂として表 1 の如く、ポリアミド (2種類)、ポリエーテルサルホン、ポリフェニレンオキサイド、ポリカーボネートを使用した。

まず、上記PPSと熱可塑性樹脂を用いて樹脂 状物質を以下のように調製した。

2 2 0 ℃のαークロロナフタレン中に、PPS と各熱可塑性樹脂を配合比 5 0 / 5 0、全樹脂分 濃度 1 0 重量%となるように添加し、約 1 時間機 神しながら溶液プレンドさせ、競神下で冷却折出 した後、更にメタノールを加え折出物を分離し、 120℃で約5時間真空乾燥させて樹脂状物質を 得た。

また、比較例として樹脂状物質を含まない場合を示す。

表 1

		配合組成	高速引張試験	曲げ	試 験
$\mid \times \mid$	热可塑性樹脂	(PPS/熱可塑性樹脂/樹脂状物質)	破壊エネルギー	破壊エネルギー	伸 び
		(重量%)	(Kgf · mm)	(Egf · mm)	(%)
実施例1		(50/45/5)	9. 5	1 5. 8	4. 2
比較例1	ナイロン66	(50/50/0)	5. 0	9. 1	3. 0
実施例 2	- 2	(50/45/5)	8. 0	1 3. 5	3. 5
比較例 2	ナイロン MXD6	(50/50/0)	4. 4	9. 0	2. 7
実施例3	ポリエーテル *3	(50/45/5)	8. 5	2 4. 5	5. 0
比較例3	サルホン	(50/50/0)	3. 5	1 7. 0	4. 0
実施例 4	ポリフェニレン**	(50/45/5)	6.0	1 2. 6	3. 8
比較例 4	、オキサイド	(50/50/0)	3. 4	8. 6	3. 1
実施例 5	# 12 A 22 A 1	(50/45/5)	1 3. 5	1 8. 0	5. 1
比較例 5	ポリカーボネート	(50/50/0)	6. 1	9. 0	3.0
参考例	PPS	(100/0/0)	2. 5	7. 5	2. 3

- \*1 ナイロン66: BASP 社製
- \* 2 ナイロン MXD6 : RENY 6301 三菱瓦斯化学社製
- \*3 ポリエーテルサルホン: PES 3600 【C I 社製
- \*4 ポリフェニレンオキサイド:ユピエース AV60 三菱瓦斯化学社製
- \* 5 ポリカーボネート:ユーピロン S-2000 三菱瓦斯化学社製

### 実施例6~8、比較例6~8

PPSーナイロン66系(実施例6)、PPSーポリエーテルサルホン系(実施例7)、PPSーポリカーボネート系(実施例8)について登した。表、2~表、4に記載の如き配合比別した。表、2~表、4に記載の如き配合比別のPPSー熱可塑性樹脂各系に対して樹脂状物質5重量%を含有させた場合と無添加の場合について調整では験した。また、比較例として樹脂状物質を含まないものについて同様には験した。

尚、サンプルの形状はアイゾット衝撃強度では 断面積3.15×3.15 mm\*のものを、引張り衝撃 強度では径1.5 mm / のものを用いた。

表. 2~表. 4の結果より、樹脂状物質を含む ものは強度が向上していることがわかる。 1.2 PPS/ナイロン66系

PPS,	/ナイロン(	PPS/ナイロン66 (第3成分)	90/10	07/10 80/20 70/30 50/50 01/06	70/30	05/05	30/70
1200	<b>東西</b>	(抵助状物質·5%含)	7.0	7.0 7.4 7.8	7.8		9.5 14.2
(kgf · cm/cm²)	比较的6	(地路伏物質・ 無 )	4.2	4.8	2.3	2.5	<b>5.</b> 6
変象(登)	海路916	( <b>世間状物質・5%</b> 舎) 22		2.4	5 8	3 2	4.2
(kg(·cn/cm²)	比较好6	(出版状物質・無)	用) 16 19 21	6 1		9 2	2.9

9

# 3 PPS/ボリエーナガサンボンボ

PPS	S/PES	PPS/PES (第3成分)	90/10	90/10 80/20 02/30 20/30 30/10	70/30	50/50	30/70
1200	奥撒 7	(樹脂 <del>以物質・5%含)</del>	5.0	5.0 6.0 7.2 10.0 16.2	7.2	10.0	1 6.2
(kgf. cn/cm²)	五 五 元	(樹脂状物質・無) 4.2 4.5 4.8 5.9 8.2	4.2	4.5	4.8	5.3	8.2
引張り後撃	光器 7	( <b>热脂状物質</b> ·5%含) 26 30 34 40 50	26	3.0	3.4	40	5.0
(kgf·cn/cn²) 比較例7	比较27	(松路伏幼寶· 無 ) 22 22 25 30 40	2.2	2.2	2.5	30	40

実施例9~13、比較例9~13

PPSーポリプチレンテレフタレート系(実施例 9)、PPSーポリフェニレンオキサイド系(実施例 10)、PPSーポリアリーレート系(実施例 11)、PPSーABS樹脂系(実施例 12)、PPSーポリエチレン(実施例 13)について、前記実施例と同様にして、それぞれの樹脂状物質を調製した。

表、5~衷、9に記載の如き配合比率のPPS - 熱可塑性樹脂各系に対して樹脂状物質を8重量 %含有させた場合(実施例9~13)と、無添加 の場合(比較例9~13)についてアイゾット衝撃試験(ノッチ無し)を行なった。

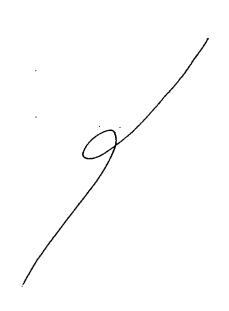
妻. 5~衷. 9の結果より、樹脂状物質を含む ものは強度が向上しているのが判る。

尚、使用した樹脂はPPS (ライトン PRO-6)、ポリブチレンテレフタレート(プラナック BT-120、大日本インキ化学工業社製)、ポリフェニレンオキサイド (ユピエース AV60 )、ポリアリーレート (Uポリマー U-100、ユニチカ社製)、ABS

メートボーカリボ/Sdd 1

l d	PS/PC	PPS/PC (第3成分)		90/10	80/20	01/08 02/09 08/00 08/08 01/06	50/50	30/J0
1 Z O D	独居38	(出版状物質・5%含) 4.5 4.4 4.4 5.5 7.9	5%合)	4.5	4.4	4.4	5.5	7.9
(kgf · cn/cm²)	五	比较例8(制脂状物質:	東	25 1.6 1.2 30 5.2	1.6	1.2	3.0	5.2
引張り御撃	<b>海龍東8</b>	(地路状物質・5%含) 18 17 17 30 40	5%合)	8 1	17	17	3.0	4.0
(kgf. ca/ca²)	开数署8	(把贴状物質・	無) 14 10	14	i	7.0 16 28	16	28

樹脂(スタイラック、旭化成工業社製)、ポリエチレン(ショーレックス P5010、昭和電工社製)である。





6.5 ر ج

4.8 30

4.1 2.8

4.0 2.9

27

(抵贴状物質・ 無 ) (細弦物質·8%会)

¥ ₩K

(単位: kgf· ca/ca\*)

90/10 80/20 70/30 60/40 50/50

PPS/PBT (第3成分)

6 6

室 逐 壑 絽

PPS/ポリプチレンテレフタレート系

လ

惠

PPS/ポリアリーレート採 影

- 1	РР	S	*	PPS/ボリアリーレート (第3成分)	90/10	70/30	20/20	30/70
寒	搊	窎	-	(HIBK初度・8%会)	5.4	6.8	11.5	2 0.5
H.	22	罫	=	(根脂状物質・無 )	3.6	4.5	7.5	15.4

(単位: kgf· ca/cu²)

PPS/変性ポリフェニレンオキサイド系 我

85 /SE	6.4	3.5
60/40	5.8	3.8
70/30	5.3	2.9
90/10 80/20 10/30 60/40 50/50	5.3	6.2
90/10	5.2	3.2
	· 8%含)	英
PPS/PPE (第3成分)	(机路状物質・	(地路代物館・
PPS/P	1.0	₩ ₩ 10
	室	翠
	摇	\$
	€K	퐈

## (単位: kgf· ca/ca\*)

S (第3成分)	01/06	02/08	0E/0L
(地路伏物質·8%台)	4.5	4.8	4.8
(細計(物質・無 )	3.5	3.4	3.5

PPS/ABS (第3成分)

田田 熠 旣

PPS/ABS鐵脂

œ ## 8/8

### (単位: kgf· cm/cm<sup>5</sup>)

98

### 実施例14~17

PPSーナイロン66(実施例14)、PPSーポリエーテルサルホン(実施例15)、PPSーポリブチレンテレフタレート(実施例16)、PPSーポリフェニレンオキサイド(実施例17)、について、前記実施例と同様にしてそれぞれの樹脂状物質を調製した。

溶融プレンドはPPSと各樹脂状物質について 行ない、アイゾット衝撃試験(ノッチ無し)を行 なった。結果は表、10に示す。

尚、使用した樹脂は前記実施例と同様のものである。

9

### 比較例14~16

PPS(ライトン PRO-6)にプレンドする熱可塑性樹脂として、前記実施例中で用いたナイロンー66(比較例14)、ポリカーボネート(比較例15)、ポリプチレンテレフタレート(比較例16)を用い、更にPPSと前記熱可塑性樹脂とのプレンド相溶化剤としてノボラック系エポキシ樹脂(エピクロン N695、大日本インキ化学工業社製)を用いた樹脂組成物を使用して耐衝難試験用のサンプル作成を試みた。

PPS/各熱可塑性樹脂/ノボラック系エポキシ樹脂の配合重量比が(50/48/2)と(80/18/2)の場合についてぞぞれ行ったが、いずれの場合も成形時にゲル化が生じ、溶融粘度が高くなってサンプル片の作成ができなかった。

代理人 弁理士 高 橋 勝 利

表 9 PPS/ボリエチレン系

70 × 30	4.8	3.7
	4.5	3.8
80 / 10 80 / 50	4.4	3.6
E (第3成分)	( <b>松路状物質·8%</b> 舍)	(網路状物質・無)
PPS/PE	実 插 例 13	比較例 13

単位 kgf·ca/ca\*)

単位 kgf· cu/cm\*)

	胡脂状物質を呼吸するた	めに用いた熱可避性樹脂	90/10	70/30	'	M M M
实施例14	99/14/4	71 4700	7.8	8.2	50/50 1 0.1	30/70 14.8
実施例15	ポリエーテル ポリプチレン	サルホン	6.5	7.5	120	18.5
实验例16	ポリプチレン	サルホン テレフタレート	5.4	6.9	8.7	8.8
实施例17	ポリフェニレン	オキサイド	5.0	6.3	7.2	8.5